

环氧导热凝胶 TSE100

Epoxy Thermal Conductive Adhesive TSE100

产品概述

TSE100 是单组分环氧体系液态导热粘接胶，产品具有良好的触变性和低粘度，在导热凝胶的基础上提高了其产品的粘结强度。当受到外力作用时可以很容易填充到发热器件表面及周边缝隙中与散热片形成导热膜桥。产品在高温加速固化后，具有良好的弹性模量，协助缓解发热器件因发热后热膨胀释放的应力，保护元器件不受损伤。可典型应用于电动汽车电池组、汽车电子设备、LED 照明、主机和小型办公室网络设备、大型存储设备及智能手机模块和消费电子等产品中。

产品特性

外观	白色粘稠液体
粘度 (Brookfield CP52, mPa.s(cP))	150000
密度 (ASTM D792, g/cm ³)	1.8
挤出速率 (2mm 针头 90psi, g/min)	≥20
储存条件 (<25°C, months)	5

产品固化条件

操作时间@100°C, min	60
固化时间@120°C, min	40

产品性能

项目	测试方法	单位	数值
导热系数	ASTM D5470	W/mK	1.0
体积电阻	ASTM D257	Ohm-meter	10 ¹³
总失重	ASTM E595	%	0.01
硬度 (shore D)	ASTM D2240	--	90
热膨胀系数	ASTM C531	x10 ⁻⁶ /°C	35
损耗因子	ASTM D150	1MHz	0.010-0.022
阻燃等级	UL94	--	V-O
介电常数	ASTM D150	25 °C, 1 kHz	3-4.8
介电强度	ASTM D149	kV/mm	20
剪切强度	--	MPa	15

产品包装及货期

小包装	30CC、300CC 针管
大包装	20L 桶装
最小包装量 (MPQ)	30CC
最小订单量 (MOQ)	30CC
交货期 (L/T)	10-15 个工作日